

**东吴证券股份有限公司**

**关于**

**江阴市赛英电子股份有限公司**

**向不特定合格投资者公开发行股票**

**并在北京证券交易所上市**

**之**

**上市保荐书**

**保荐机构（主承销商）**



**（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）**

## 声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）接受江阴市赛英电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构（主承销商）。本保荐机构经过审慎调查与投资银行业务内核委员会的研究，认为发行人的本次证券发行上市符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）的有关规定，特出具本上市保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确和完整。

（如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《江阴市赛英电子股份有限公司招股说明书》相同。）

# 目 录

声明 .....	1
目 录 .....	2
第一节 发行人基本情况 .....	3
一、公司概况.....	3
二、发行人主营业务.....	4
三、发行人核心技术.....	5
四、发行人研发水平.....	6
五、发行人主要经营和财务数据及指标.....	7
六、发行人存在的主要风险.....	8
第二节 发行人本次证券发行情况 .....	13
第三节 本次证券发行的保荐代表人及项目组成员情况 .....	14
一、本次证券发行的保荐代表人.....	14
二、本次证券发行的项目协办人.....	14
三、其他项目组成员.....	14
第四节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 .....	15
第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 .....	16
第六节 发行人针对本次证券发行上市已经履行的内部决策程序情况 .....	17
第七节 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明以及选 择的具体上市标准的说明 .....	18
一、发行人符合《上市规则》规定的上市条件.....	18
二、发行人选择的具体上市标准.....	20
第八节 持续督导期间的工作安排 .....	21
第九节 保荐机构和保荐代表人的联系方式 .....	23
第十节 发行人的创新发展能力核查情况 .....	24
第十一节 保荐机构对发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市的保荐结论 .....	26

## 第一节 发行人基本情况

### 一、公司概况

公司全称	江阴市赛英电子股份有限公司
英文全称	Jiangyin Saiying Electron Co., Ltd.
证券代码	874558
证券简称	赛英电子
统一社会信用代码	91320200743703794R
注册资本	3,240 万元
法定代表人	陈国贤
成立日期	2002 年 11 月 1 日
办公地址	江苏省无锡市江阴市南闸街道开运路 60 号
注册地址	江苏省无锡市江阴市南闸街道开运路 60 号
邮政编码	214400
电话号码	0510-86170325
传真号码	0510-86276840
电子信箱	SY-IR@saiyingelec.com
公司网址	www.saiyingelec.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
董事会秘书或者信息披露事务负责人	薛伶俐
投资者联系电话	0510-86170325
经营范围	电子元器件的生产、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主营业务	陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件的研发、制造和销售
主要产品与服务项目	以陶瓷管壳和封装散热基板为核心的产品结构，为功率半导体厂商提供用于晶闸管、IGBT 和 IGCT 等功率半导体模块的关键部件产品

## 二、发行人主营业务

公司是专业从事陶瓷管壳和封装散热基板等功率半导体器件关键部件研发、制造和销售的国家高新技术企业。公司产品主要应用于晶闸管、IGBT 和 IGCT 等功率半导体器件，应用领域覆盖发电、输电、变电、配电、用电等电力系统全产业链，在特高压输变电、新能源发电、工业控制、新能源汽车、智算中心、轨道交通等领域发挥重要作用，市场前景广阔。

公司专注大功率半导体器件用陶瓷管壳研发制造二十余年，通过持续研发创新，攻克等静压陶瓷高渗透金属化扩散难、多介质焊接内应力大等行业技术难题，掌握高密度等静压陶瓷金属化扩散、超大直径陶瓷金属高强度高真空焊接等核心技术，在陶瓷管壳行业内占据领先地位。公司产品线覆盖多规格陶瓷管壳，广泛应用于特高压输变电、新能源发电、工业控制、智算中心和轨道交通等领域。公司作为第一起草单位、陈国贤和徐宏伟作为主要起草人起草制定的团体标准《压接式绝缘栅双极晶体管（IGBT）平板陶瓷管壳》（T/CITIA 203-2018）于 2018 年 9 月发布，并于 2025 年 5 月 9 日经工业和信息化部批准发布成为行业标准《压接式绝缘栅双极晶体管（IGBT）平板陶瓷管壳》（SJ/T 11972-2025）。该标准的发布对规范 IGBT 平板陶瓷管壳技术发展路径、推动技术创新与产业链协同、促进产业升级和提升国际竞争力具有重要意义，显示了公司在陶瓷管壳行业内的市场引领地位。

公司深度融入国家战略性新兴产业发展，突破冷锻、预弯、连续电镀等关键工艺，构建封装散热基板核心技术体系，于 2017 年开拓封装散热基板业务。依托精密加工能力与稳定可靠的产品品质，公司已与中车时代、客户 A、宏微科技等形成长期稳定的合作关系，2020 年、2022 年荣膺中车时代“战略合作奖”，行业影响力和市场地位持续提升。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省民营科技企业及无锡市瞪羚企业。公司承担并完成了 7 项国家级及省级科研项目，包括工业和信息化部工业强基工程项目“柔性高压直流输电用平板全压接大功率 IGBT 多台架精密陶瓷结构件产业化”、工业和信息化部电子信息产业发展基金项目“全压接式大功率 IGBT 多模架精密陶瓷外壳”、科技部科技型中小企业技术创新基金项目“轻型高压直流输电用平板压接式 IGBT 多模架陶瓷管壳研

发及产业化”、“平板全压接式大功率 IGBT 多模架精密陶瓷管壳”和“大功率集成门极换流晶闸管（IGCT）用精密外壳”、江苏省科技成果转化项目“高压大功率器件陶瓷封装系列产品研发及产业化”、江苏省科技支撑计划项目“千安级 IGBT 陶瓷封装结构研究”等，核心竞争力显著增强。

公司形成了一支经验丰富、高度协作的研发技术团队，建立了合理的组织架构、规范的管理流程和完善的人才激励机制。近年来，公司持续加大产品及技术升级，形成了超大直径陶瓷金属高强度高真空焊接、平底基板异形弧度成型技术、针齿基板多穴位一次冷锻等核心工艺技术，与华中科技大学等科研院所建立了长期的合作关系。截至 2025 年 12 月 31 日，共拥有专利 53 项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 44 项。

报告期内，公司主营业务未发生过重大变化。

### 三、发行人核心技术

公司的核心技术基本情况如下：

序号	技术名称	技术来源	技术应用情况
1	大功率 IGBT 平板压接式封装结构设计开发技术	自主研发	平板压接式 IGBT 用陶瓷管壳的结构设计
2	超大直径陶瓷金属高强度高真空焊接技术	自主研发	6 英寸超大直径陶瓷管壳金属材料 and 瓷件连接处的焊接工序
3	高密度等静压陶瓷金属化扩散技术	自主研发	各类陶瓷管壳陶瓷金属化工序
4	超大规格方型陶瓷管壳低应力钎焊技术	自主研发	平板压接式 IGBT 用陶瓷管壳焊接工序
5	压接式封装电极超精细表面技术	自主研发	平板压接式 IGBT 用陶瓷管壳表面处理工序
6	压接式封装电极局部电镀工艺	自主研发	平板压接式 IGBT 用陶瓷管壳电镀工序
7	针齿基板多穴位一次冷锻工艺	自主研发	精密、形状复杂且可承受高负载的高强度针齿型封装散热基板冷锻工艺
8	针齿基板齿区域单向深镀工艺	自主研发	针齿型封装散热基板电镀工序
9	针齿基板多工位高精度机加工工艺	自主研发	针齿型封装散热基板 CNC 机加工工序
10	平底基板异形弧度成型技术	自主研发	平底封装散热基板预弯弧度工序
11	平底基板高分散通过式连续电镀工艺	自主研发	平底封装散热基板电镀工序

序号	技术名称	技术来源	技术应用情况
12	针齿基板外观视觉自动检测技术	自主研发	针齿型封装散热基板外观检测工序
13	IGBT 平底基板点云曲面拟合弧度检测技术	自主研发	平底封装散热基板弧度检测工序

#### 四、发行人研发水平

##### (一) 正在从事的研发项目

截至报告期末，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

单位：万元

项目名称	主要研发人员	报告期内研发投入	拟达到目的	技术参数及技术水平	所处阶段
多工步高精度连续模成型工艺的研发	徐宏伟、薛晨涛等	321.04	通过连续模工艺实现冲制、凸点、沉孔、弧度预弯在一副模具上加工多个工步，保证精度和一致性，减少多次装加，达到和工程模一样的精度水平，大幅提高生产效率。	1、模具制造精度控制在 $\pm 0.02\text{mm}$ 以内，弧度成型的点位公差控制在 $0.05\text{mm}$ 以内，确保后续批量生产过程中曲面的一致性和稳定性，高于基板行业内普遍精度 $\pm 0.1\text{mm}$ 内； 2、提高人均产能300%。	研发中
功率模块基板异形微结构一体化制造技术的研发	张琼、陆明豪等	111.60	通过开发一种功率模块用铜基板上的锁胶结构制造工艺和一种焊接设计的制造工艺，以提高功率模块的焊接性能。	1、结构成型一致性合格率 $\geq 90\%$ ； 2、关键结构尺寸公差 $\leq \pm 0.05\text{mm}$ ； 3、表面缺陷发生率 $< 5\%$ ，提高产品外观与功能可靠性； 4、基板平整度公差 $\leq \pm 0.05\text{mm}$ 。	研发中
6英寸刚性压接IGBT陶瓷管壳的研发	张琼、薛晨涛等	100.43	通过工艺开发，解决6英寸IGBT陶瓷管壳钎焊难的问题，达到高气密性高平整度的要求。	1) 耐压等级为 $18\text{kV}$ ，在 $60$ 秒内飞弧无法击穿； 2) 电极平整度要求达到 $0.005\text{mm}$ 以下，保证高效散热； 3) 抗拉强度达 $7.200\text{kN}$ ； 4) 应力试验：高温 $200^\circ\text{C}$ ，低温 $-60^\circ\text{C}$ ，转移时间小于 $3$ 分	研发中

项目名称	主要研发人员	报告期内研发投入	拟达到目的	技术参数及技术水平	所处阶段
				钟, 循环 5 次, 漏率 $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pam}^3/\text{s}$ ; 5) 盐雾试验: 持续时间 24h, 漏率 $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pam}^3/\text{s}$ 。	

## (二) 研发投入情况

报告期内, 公司研发投入金额及占营业收入的比例情况如下:

单位: 万元

项目	2025 年	2024 年度	2023 年度
研发投入	2,205.58	1,446.00	1,027.74
营业收入	60,001.98	45,726.22	32,055.15
研发投入占营业收入比例	3.68%	3.16%	3.21%

报告期内, 公司研发投入金额稳步提升, 公司坚持技术创新为核心, 在技术研发和产品创新方面持续投入资金, 不断增强公司核心竞争力。

## 五、发行人主要经营和财务数据及指标

单位: 万元

项目	2025-12-31/ 2025 年	2024-12-31/ 2024 年	2023-12-31/ 2023 年
资产总计	55,044.42	44,318.82	29,878.77
股东权益合计	46,897.83	37,699.98	25,456.83
归属于母公司所有者的股东权益	46,897.83	37,699.98	25,456.83
资产负债率 (%)	14.80	14.93	14.80
营业收入	60,001.98	45,726.22	32,055.15
毛利率 (%)	25.80	27.01	28.85
净利润	8,807.79	7,390.15	5,506.83
归属于母公司所有者的净利润	8,807.79	7,390.15	5,506.83
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润	8,768.57	7,371.91	5,537.54
加权平均净资产收益率 (%)	20.82	25.20	24.36
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	20.73	25.14	24.50

项目	2025-12-31/ 2025 年	2024-12-31/ 2024 年	2023-12-31/ 2023 年
基本每股收益（元/股）	2.72	2.45	1.84
稀释每股收益（元/股）	2.72	2.45	1.84
经营活动产生的现金流量净额	2,654.85	-772.26	1,720.43
研发投入占营业收入的比例（%）	3.68	3.16	3.21

## 六、发行人存在的主要风险

### （一）经营风险

#### 1、客户集中度较高的风险

公司主要客户中车时代、客户 A、英飞凌、日立能源、斯达半导体、宏微科技等均为功率半导体行业内知名企业，规模较大。报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 82.22%、80.92%和 **80.07%**，客户集中度较高。

未来，若公司产品质量、技术创新或生产交货周期等无法满足主要客户的要求，或公司主要客户的经营或财务状况出现不利变化，新客户开发进展较慢，将对公司短期内的持续经营能力有一定影响，并对公司经营业绩造成不利影响。

#### 2、市场竞争风险

近年来，在国家政策支持下，功率半导体行业得以快速发展，市场竞争也随之加剧。若未来下游市场需求不及预期，市场竞争压力不断增大，公司业务发展将面临市场竞争加剧的风险，对经营业绩造成不利影响。

#### 3、主要原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为铜材，铜材价格变动是公司生产成本变化的主要因素之一，报告期内，铜材平均采购价格分别为 6.54 万元/吨、7.16 万元/吨和 **7.62 万元/吨**，总体呈上升趋势。随着公司销售收入的增加，铜材消耗量也逐年增加。如果未来铜材价格持续大幅波动，将直接影响公司的生产成本，从而影响公司的利润。如果未来原材料价格持续大幅上升，公司产品价格不能同步上涨，将对盈利能力产生不利影响。

#### 4、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额分别为 19,067.76 万元、28,048.09 万元和 **36,132.58 万元**，占采购总额的比例分别为 85.63%、82.21% 和 **80.54%**，供应商集中度较高。如果公司与主要供应商合作出现不利变化，仍可能对公司短期内的经营业绩造成不利影响。

#### 5、细分领域市场空间较小的风险

报告期内，公司产品分为陶瓷管壳、封装散热基板两大类，产品定位于功率半导体器件关键部件领域，相关市场规模相对有限。若未来行业政策、下游应用需求或市场竞争格局发生不利变化，或公司不能在该细分领域保持现有市场竞争优势，则可能对经营业绩和未来成长性产生不利影响。

### （二）财务风险

#### 1、应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 8,780.59 万元、13,282.39 万元和 **14,204.67 万元**，占各期营业收入比重分别为 27.39%、29.05%和 **23.67%**。随着公司收入规模的持续增长，公司应收款项可能进一步上升。

如果未来宏观经济形势、功率半导体行业等方面出现重大不利变化，使得客户无法按期付款或大幅延长付款周期，将导致公司应收款项逾期、面临一定的坏账风险，并对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

#### 2、存货减值的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,805.25 万元、10,335.61 万元和 **12,219.88 万元**，占流动资产的比例分别为 34.72%、28.17%和 **29.58%**，金额较高。若未来宏观经济形势、功率半导体行业政策、客户经营情况等方面出现重大不利变化，公司产品价格可能出现大幅下降，导致公司存货可变现净值低于账面价值，存在存货减值的风险。

#### 3、主营业务毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 31.36%、30.09%和 **30.25%**，整体较为平稳。报告期内，公司主营业务毛利率受市场竞争情况、原材料价格、技

术水平、产品结构、订单情况等多种因素影响。未来若公司不能根据市场环境及时调整，或销售价格、采购成本等出现较大不利变化，将面临主营业务毛利率下降的风险。

#### **4、汇率波动风险**

报告期内，公司主营业务中外销收入分别为 6,896.06 万元、8,535.51 万元和 **13,364.05** 万元，占主营业务收入的比例分别为 23.42%、21.02%和 **26.36%**。未来，若境外经济环境、货币政策等发生变化，汇率波动幅度加大，可能导致公司汇兑损益波动增大，从而对经营业绩产生影响。

#### **5、净资产收益率及每股收益下降的风险**

本次发行完成后，公司净资产及股本会相应增加。但由于本次发行募集资金投资项目的实施周期较长，在项目实施初期，募集资金投资项目难以对公司净利润产生较大贡献。因此，公司存在净资产规模上升导致摊薄净资产收益率的风险，以及股本增加导致每股收益下降的风险。

### **（三）技术风险**

#### **1、核心技术泄露风险**

公司凭借在陶瓷管壳及封装散热基板领域多年的研发投入，已经积累了多项核心技术，截至 **2025 年 12 月 31 日**，共拥有专利 **53 项**，其中发明专利 **9 项**，实用新型专利 **44 项**。核心技术的保密对于公司的经营和发展至关重要，如果公司因管理不善、外界恶意窃取等导致核心技术泄密，将可能对公司核心竞争力产生不利影响。

#### **2、核心技术人员流失风险**

人才队伍是公司提升核心竞争力的关键因素。公司存在掌握核心技术的人员不稳定，导致研发项目进度推迟、甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失的风险，给公司新产品开发以及业绩持续稳定增长带来不利影响。

#### **3、技术升级迭代失败风险**

公司深耕功率半导体器件关键部件研发和制造领域多年，核心竞争力主要来源于长期的工艺技术和生产制造经验积累。如果公司不能持续跟踪前沿技术

并更新自身的技术储备，或竞争对手率先取得突破性技术，则可能导致公司生产经营所依赖的技术或主要产品的市场竞争力下降，出现竞争对手的同类产品在性能、质量、价格等方面优于公司产品的情况，将可能对公司的生产经营状况造成较大影响。

#### **（四）法律风险**

##### **1、产品质量控制风险**

公司的主要产品陶瓷管壳和封装散热基板是功率半导体器件的关键部件，与下游市场有密切的关联。随着规模的不断扩大，公司质量控制能力可能无法跟上经营规模扩张的速度。如果公司产品出现质量问题，影响到客户产品的质量稳定性，可能引发赔偿要求和诉讼等问题，将对公司业务开展产生不利影响。

##### **2、安全生产与环境保护的风险**

公司生产过程中涉及冲压、锻压、焊接等环节，存在因操作失误等偶发因素造成安全事故的风险。一旦发生重大安全事故，公司正常的生产经营活动将受到不利影响。

公司生产过程中会产生废气、废水、固体废物等污染物，公司存在因员工操作失误、污染处理设施发生故障等偶然因素造成环境污染事故并导致被主管部门处以行政处罚的风险。

#### **（五）募集资金投资项目风险**

##### **1、募集资金投资项目管理和组织实施的风险**

本次发行所募集的资金将用于公司的主营业务，募集资金投资项目是公司根据整体发展战略与规划做出的，与公司的经营规模、财务状况、技术水平、管理能力及未来资本支出规划等相适应。募集资金投资项目管理和实施将涉及到项目设计、项目预算编制、人才培养等多个环节，项目建设周期较长，项目能否按计划完成、项目的实施过程及实施效果等均存在一定的不确定性。如果市场环境、产业政策、行业格局等发生重大不利变化，公司募集资金投资项目的实施进度及实施效果可能受到影响。

## **2、募集资金投资项目新增产能无法消化及未达预期效益风险**

本次募投项目建成达产后，公司将新增 1,200 万片平底型封装散热基板与 600 万片针齿型封装散热基板产能；同时，项目竣工后的每年需要新增折旧摊销 1,212.26 万元。如果未来在募投项目实施过程中，宏观经济环境、市场需求、行业竞争状况、国际贸易政策等因素发生不利变化，公司将面临无法及时消化新增产能的风险，并使得募投项目收益不达预期。

### **（六）实际控制人不当控制风险**

截至本上市保荐书签署日，公司控股股东、实际控制人为陈国贤、秦静、陈蓓璐和陈强，本次发行前合计控制公司 79.87%表决权。如果控股股东、实际控制人利用其对公司的控制地位，对公司的生产经营、对外投资、关联交易、人事管理等方面进行不当控制，则可能损害公司和其他股东的利益。

### **（七）其他风险**

#### **1、发行失败的风险**

公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种因素的影响，可能存在因认购不足导致发行失败的风险。

#### **2、股价波动的风险**

公司股票的二级市场价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，同时也受投资者的心理预期、股票供求关系、境内外资本市场环境、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等多种因素的影响。未来，公司股票的市场价格可能存在一定的波动性风险，给投资者造成直接或间接投资损失。

## 第二节 发行人本次证券发行情况

公司本次证券发行情况如下表所示：

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	发行人拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,080 万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 162 万股（含本数），具体发行数量将由发行人与主承销商根据具体情况协商确定，并经中国证监会注册后确定。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份。
定价方式	发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由发行人股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
每股发行价格	以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时协商确定。
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。
发行对象	已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者（法律、法规和规范性文件禁止认购的除外）
承销方式及承销期	主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件	符合北交所要求的合格投资者

## **第三节 本次证券发行的保荐代表人及项目组成员情况**

### **一、本次证券发行的保荐代表人**

保荐代表人：孙虎

保荐业务执业情况：2021 年取得保荐代表人资格，曾担任华亚智能（003043）IPO 协办人，曾参与万祥科技（301180）IPO 等项目，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

保荐代表人：夏建阳

保荐业务执业情况：2016 年取得保荐代表人资格，曾组织或参与上海凯宝（300039）IPO、蓝丰生化（002513）IPO、南京银行（601009）2015 年非公开发行优先股、高科石化（002778）IPO、南京证券（601990）IPO、中泰证券（600918）IPO、上声电子（688533）IPO、圣晖集成（603163）IPO、中裕科技（871694）北交所 IPO 等项目，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### **二、本次证券发行的项目协办人**

骆云天，曾参与圣晖集成（603163）IPO，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### **三、其他项目组成员**

朱子啸、陆逸峰、周一夫、张博雄、沈彦杰

## 第四节 关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

经自查，本保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份达到或超过 5%的情形；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份达到或超过 5%的情形；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方任职的情形；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。

## 第五节 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及北京证券交易所相关规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》的相关规定，本保荐机构作出如下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、北京证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会、北京证券交易所的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）自愿接受北京证券交易所的自律管理；

（十）中国证监会、北京证券交易所规定的其他事项。

## **第六节 发行人针对本次证券发行上市已经履行的内部决策程序情况**

### **（一）本次证券发行已获得发行人董事会审议批准**

2025年4月29日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》等与本次公开发行相关的议案。

### **（二）本次证券发行已获得发行人股东会审议批准**

2025年5月20日，发行人召开2024年年度股东会，以逐项表决方式审议并通过发行人第四届董事会第三次会议提交审议的与本次发行上市相关的议案。

## 第七节 保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明以及选择的具体上市标准的说明

### 一、发行人符合《上市规则》规定的上市条件

#### (一) 发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条相关规定

1、发行人股票曾于 2016 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统首次挂牌，后于 2019 年 12 月 11 日摘牌。2025 年 4 月 14 日，发行人股票在全国中小企业股份转让系统重新挂牌，自 2025 年 5 月 20 日进入创新层，发行人符合在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的条件。

2、发行人符合中国证监会规定的发行条件。

3、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》（中汇会审[2026]0850 号），2025 年末发行人归属于母公司所有者的净资产为 46,897.83 万元，不低于 5,000 万元。

4、本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 1,080 万股股票（未考虑超额配售选择权的情况下），不少于 100 万股，发行对象不少于 100 人。

5、发行人目前股本总额 3,240 万元，公开发行后，公司股本总额不少于 3,000 万元。

6、公开发行后，公众股东持股比例不低于本次公开发行完成后公司股本总额的 25%；公开发行后，公司股东人数不少于 200 人。

7、根据最近一次外部融资估值及同行业可比公司估值情况，发行人预计市值不低于人民币 2 亿元；2024 年、2025 年公司扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为 7,371.91 万元、8,768.57 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 25.14%、20.73%。报告期内，公司的收入、利润保持稳定，净资产收益率保持较高水平，预计向不特定合格投资者公开发行价格计算的股票市值不低于 2 亿元；

8、发行人符合北京证券交易所要求的其他上市条件。

发行人符合北京证券交易所规定的其他上市条件，符合《上市规则》第 2.1.2 条第（八）项之规定。

## （二）发行人不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的情形

1、根据相关主管部门向发行人出具的合规证明及控股股东、实际控制人无犯罪记录证明、发行人及其控股股东、实际控制人出具的基本情况调查表及说明承诺文件并经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪；不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

2、结合前述核查程序，并根据董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员无犯罪记录证明及前述主体出具的基本情况调查表及说明承诺文件，并经查询国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、信用中国等网站，保荐机构认为：发行人及其控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员最近 12 个月内不存在被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；或因证券市场违法违规行为受到全国股转公司、证券交易所等自律监管机构公开谴责的情形；

3、结合前述核查程序，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员因不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的情形；

4、结合前述核查程序，发行人及其控股股东、实际控制人不存在被列入失信被执行人名单且情形尚未消除的情形。

5、发行人 2016 年至 2019 年首次挂牌期间以及 2025 年重新挂牌以来，能够及时披露年度报告和半年度报告，不存在未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上

半年结束之日起 2 个月内编制并披露半年度报告的情形。

6、报告期内，发行人的经营业绩持续增长，最近 24 个月内主营业务未发生重大变化，最近 24 个月内实际控制人未发生变更；最近 24 个月内董事、高级管理人员未发生重大不利变化，满足经营稳定性的要求。经核查，发行人业务、资产、人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响发行人独立性或者显失公平的关联交易；发行人或其控股股东、实际控制人、占发行人主营业务收入或净利润比例超过 10%的重要子公司不存在被列入失信被执行人名单且尚未消除的情形，满足直接面向市场独立持续经营的能力。同时，发行人不存在利益受到损害等其他情形。

综上，经核查，发行人不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的情形。

综上所述，保荐机构认为，发行人符合《上市规则》的相关规定。

## 二、发行人选择的具体上市标准

根据《上市规则》第 2.1.3 条，发行人选择第一套标准，即“（一）预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%”。

根据发行人股票交易情况及同行业可比公司估值情况，发行人预计市值不低于人民币 2 亿元；**2024 年、2025 年**公司扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低分别为 7,371.91 万元、**8,768.57 万元**，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 25.14%、**20.73%**，符合《上市规则》第 2.1.3 条第（一）项的要求。

## 第八节 持续督导期间的工作安排

事项	安排
(一) 持续督导事项	在本次发行证券上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度对发行人履行持续督导职责。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	1、督导发行人进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，及时了解发行人的重大事项，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	1、督导发行人进一步完善已有的防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人进一步完善保障关联交易公允性和合规性的制度； 2、督导发行人及时向本保荐机构通报将进行的关联交易情况，本保荐机构将对关联交易的公允性、合规性发表意见； 3、督导发行人严格执行有关关联交易的信息披露制度。
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	1、本保荐机构将定期了解发行人的募集资金使用情况、项目进展情况； 2、在项目完成后，本保荐机构将及时了解发行人项目达产情况、是否达到预期效果，并与有关募集资金投资项目的披露信息进行对照，如发生差异，将敦促发行人及时履行披露义务，并向有关部门报告； 3、如发行人拟改变募集资金使用方案，本保荐机构将督导发行人履行相应审批程序和信息披露义务。
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、本保荐机构将持续关注发行人提供对外担保及履行的相应审批程序情况，督导发行人执行已制定的规范对外担保的相关制度； 2、要求发行人在对外提供担保前，提前告知本保荐机构，本保荐机构将根据情况发表意见。
6、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度、财务内控制度和信息披露制度，督导发行人按照《上市规则》的规定履行信息披露及其他相关义务，审阅信息披露文件及其他相关文件	1、督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立健全并有效执行公司治理制度、财务内控制度和信息披露制度，履行信息披露义务及其他相关义务； 2、督导发行人在发生须进行信息披露的事件后，立即书面通知本保荐机构，并将相关资料、信息披露文件及报送中国证监会、证券交易所的其他文件送本保荐机构审阅。
7、督导发行人的控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员遵守北京证券交易所业务规则，履行其所作出的承诺	1、本保荐机构将持续督导发行人的控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员规范运作，严格遵守北京证券交易所业务规则各项业务规则； 2、持续关注并督导发行人的控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员严格遵守其所作出的各项公开承诺。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、对发行人拥有知情权，可要求其提供一切有关的资料； 2、有权对发行人聘请的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构相关事宜提出意见； 3、有权对发行人董事及其他高级管理人员的恰当履行职责的情况以及对发行人信息披露和规范运作义务的履行情况等

事项	安排
	<p>进行质疑，并向发行人股东大会或董事会提出意见和建议，必要时可以发表声明并向中国证监会和证券交易所报告；</p> <p>4、有权对发行人做出的收购兼并和再融资等重大决策提出意见；</p> <p>5、中国证监会规定的其他权利。</p>
<p>（三）发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定</p>	<p>发行人已在保荐协议中承诺保障本保荐机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权；其他中介机构也将对其出具的与发行上市有关的文件承担相应的法律责任。</p>
<p>（四）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作</p>	<p>根据中国证监会、北京证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，保荐机构将持续督导发行人规范运作。</p>

## 第九节 保荐机构和保荐代表人的联系方式

名称：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

住所：苏州工业园区星阳街5号

保荐代表人：孙虎、夏建阳

联系电话：0512-62938168

传真：0512-62938500

## 第十节 发行人的创新发展能力核查情况

保荐机构依据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》，对发行人的创新发展能力进行了详细核查，具体如下：

1、通过访谈发行人的实际控制人、高级管理人员和相关业务人员，了解发行人经营模式、盈利模式、研发模式、服务模式、组织架构，了解公司技术创新、模式创新和产品创新等情况；

2、通过实地走访等形式，访谈发行人主要客户及供应商，了解发行人与主要客户、供应商的合作情况，上下游企业对发行人的评价，以及发行人行业市场地位、核心竞争力、市场份额及可持续性能力；

3、查看发行人的员工名册及核心技术人员简历，了解研发人员数量及其背景，分析判断公司的人才储备及技术实力；

4、查看行业法律法规、国家政策文件、行业研究报告等，了解发行人所处行业的市场规模及发展前景、产业模式、行业地位、主要竞争对手以及技术壁垒等情况；

5、查看发行人主要竞争对手的公开信息，分析发行人的行业地位、技术和业务模式差异、核心竞争力及公司差异化优势；

6、查看发行人的销售明细表，分析发行人业务覆盖情况、产品类别情况、分季度销售情况、主要客户构成、未来业务拓展等情况，分析判断核心技术在主营业务收入中的应用情况；

7、查看发行人审计报告中的营业收入、净利润等财务数据，分析判断成长性以及盈利能力；

8、查看发行人的研发费用明细表，对报告期各期研发投入占营业收入的比例进行分析，判断发行人研发投入水平；

9、查看发行人的核心技术资料、荣誉奖项、在研项目等相关内容，分析判断发行人的创新机制和创新能力水平；

10、查看发行人持有的《高新技术企业证书》并核查发行人商标、软件著

作权等相关无形资产的权属证明文件，了解发行人的创新情况。

经核查，本保荐机构认为：

发行人是一家专业从事功率半导体器件关键部件研发、制造和销售的高新技术企业，主要产品为功率半导体用陶瓷管壳和封装散热基板。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业”中的“电力电子元器件制造”（行业代码：C3824）；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“电力电子基础元器件制造”之“电力电子元器件制造”；公司主要产品应用于功率半导体器件，根据国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》（国统字[2018]111号），属于“新能源设备制造（0213）”大类下的“电力电子基础元器件制造（021306）”，属于新产业、新业态、新商业模式的范畴。发行人自身所处行业及主营业务符合国家产业政策，并通过持续开展研发投入，在业务、技术、产品等方面具备较强创新能力及竞争优势，具备创新发展能力，创新性量化指标符合北交所要求。发行人不属于产能过剩行业（产能过剩行业的认定以国务院主管部门的规定为准）、《产业结构调整指导目录》中规定的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训等业务的企业。

综上所述，发行人符合《注册管理办法》第三条及《上市规则》第 1.4 条北交所对拟上市企业的定位。

因此，发行人运作规范，经营业绩良好，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律法规规定的向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的各项条件。公司通过高素质的技术研发团队、先进的研发设施以及持续的研发投入，不断推动技术产品创新和生产管理创新，从而稳步扩展主营业务，提升产品质量，增强盈利能力，获得了多项行业认证和荣誉，公司具有较强的创新特征。

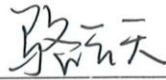
## **第十一节 保荐机构对发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐结论**

东吴证券认为，发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市符合《公司法》《证券法》和《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，发行人向不特定合格投资者公开发行股票具备在北京证券交易所上市的条件。东吴证券同意推荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票上市交易并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

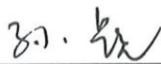
(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江阴市赛英电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人：



骆云天

保荐代表人：



孙 虎



夏建阳

内核负责人：



杨 伟

保荐业务负责人：



方 苏

法定代表人、董事长：



范 力

东吴证券股份有限公司



2026年3月6日